

JAPAN
SEMICONDUCTOR

ジャパン半導体株式ファンド
ジャパン半導体株式ファンド(予想分配金提示型)

運用者に聞く！市場の見通しや今後の注目点など

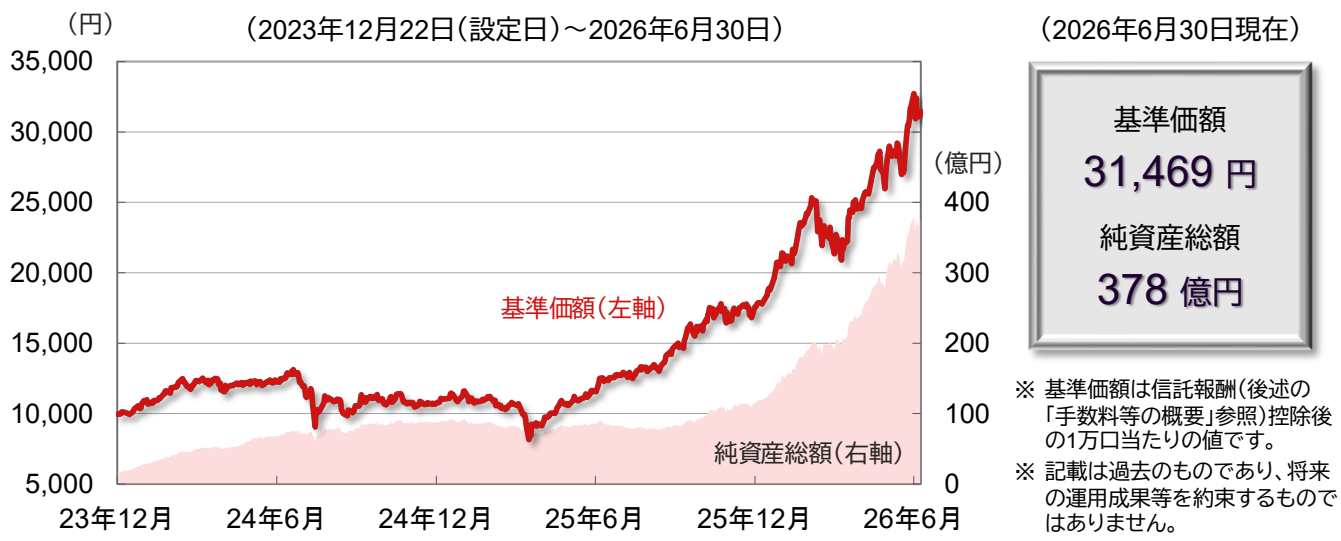
当ファンドは日本の半導体関連企業の株式を主要投資対象とします。本資料では、パフォーマンスの状況のご説明のほか、半導体市場の成長見通しや注目点などについて、当ファンドのマザーファンドの運用者からのコメントをご紹介します。

本資料の
内容

- ✓ 設定来のパフォーマンスと局面ごとの状況
- ✓ 半導体関連市場の今後の見通しについて
- ✓ 日本の半導体産業における注目点
- ✓ 組入上位銘柄のご紹介

基準価額と純資産総額の推移(1年決算型)

※当資料において、「1年決算型」は「ジャパン半導体株式ファンド」を指します。
※「予想分配金提示型」(2026年6月22日設定)は、運用期間が短いため掲載しておりません。

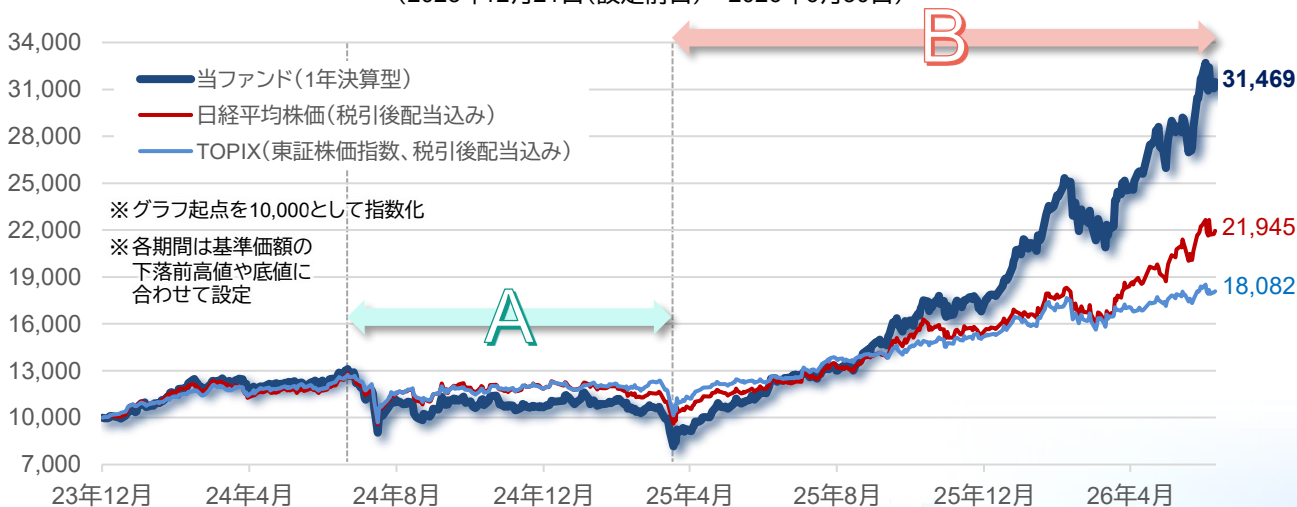


本資料はマザーファンドの運用者のコメントをもとに作成しています。本資料は、資料作成時点における市場環境について、運用者の見方あるいは考え方等を記載したものであり、将来の市場環境の変動や運用成果などを保証するものではありません。また、見解は変更される場合があります。

日本株式は2025年4月以降、大きく上昇 なかでも半導体関連銘柄は力強い上昇を遂げる

日本株式は、2024年夏の急落後は上値の重い展開となり、2025年4月には一段と値を下げました。しかし、その後は上昇基調を維持し、主要株価指数が相次いで最高値を切り上げながら推移しました。なかでも、AI・半導体の成長期待を背景に半導体関連銘柄の株価は力強い上昇を遂げました。

＜当ファンド(1年決算型)の基準価額と主要株価指数の推移および期間別騰落率＞
(2023年12月21日(設定前日)～2026年6月30日)



期間 A

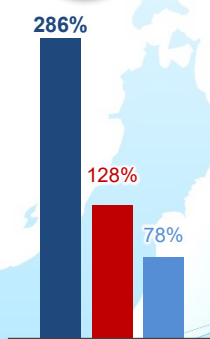
(24年7月11日～25年4月7日)

- 24年7月から9月にかけて、米中対立の激化懸念に加え、日銀の利上げ観測を受けた円高進行、米国の景気不安などが嫌気されて荒れた相場展開に
- 25年に入ると、米トランプ政権の関税政策を巡る不透明感や米景気減速懸念などから投資家のリスク回避姿勢が一段と強まる

期間 B

(25年4月7日～26年6月30日)

- 米中摩擦を巡る過度な懸念が後退したほか、26年春ごろにかけて、米利下げ観測などから市場心理が改善
- 日米企業の堅調な決算発表や円安の進行、高市新政権による財政拡張への期待などが相場を押し上げる
- AI市場の成長期待から、日本でも半導体関連銘柄が株式相場の牽引役となる
- 26年3月には、中東情勢の悪化を受けて相場が急落するも、リスク回避姿勢の後退とともに再び半導体関連銘柄を中心に株式相場は上昇基調に



■ 当ファンド(1年決算型) ■ 日経平均株価(税引後配当込み)
■ TOPIX(東証株価指数、税引後配当込み)

※ 上記のグラフは「1年決算型」の基準価額を用いて作成したものであり、「予想分配金提示型」の投資成果を示すものではありません。
※ 基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の値です。
※ 指数は当ファンドのベンチマークではありません。
信頼できると判断したデータをもとにアモヴァ・アセットマネジメントが作成

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

- Q. 半導体関連銘柄を牽引役の一つとして、日経平均株価が7万円を超える水準となりました。足元での急激な株価上昇に対し、市場では高値警戒感が強まる可能性もありますが、半導体関連株には、今後も中長期的な上昇が期待できるのでしょうか。

A. 中長期的には、AIの進化に伴う2つの成長ドライバーが半導体の需要拡大をもたらし、さらなる株価上昇につながる可能性があります

短期的には、半導体メモリなどの需給状況に左右され、株価の変動性が高まる可能性があります。しかし、半導体市場全体を中長期的に見れば、株価の上昇期待は十分にあると考えられます。例えば、最近、関連企業の株価上昇が著しいMLCC(積層セラミックコンデンサ)のように、データセンター向けの半導体に関連する分野は特に需要が大きく拡大すると見込まれ、より高い成長を遂げる可能性があります。

そして、これからの半導体産業の主要な成長ドライバーになると考えられるのは、「AI需要の拡大」と「フィジカルAI*1の進展」です。過去10年、AIはデジタル世界で大きな進展を遂げましたが、AIの進化は新たな領域へと移行しつつあり、今後は自動運転やロボットといった、リアルの世界が進化の主戦場になるとみられます。

なお、今後の懸念材料として、半導体メモリ価格の動向が挙げられます。現在、データセンター向けに限らず、各社がメモリの確保を進めていることから、需給は逼迫した状態にあります。一方で、夏以降、前倒し調達や在庫積み増しの動きが一巡すれば、その後の実需の状況が重要になります。また、メーカーの設備投資拡大によって年末から来年にかけてDRAM*2やNAND*3の供給能力拡大が見込まれるため、メモリの需給や価格動向、それらが株価に織り込まれるタイミングなどを注視していきます。

*1 現実世界の情報をセンサーなどで認識し、状況に応じた判断を行ない、モーターなどを動かして自律的に動作するAI。製造業の自動化や自動運転、サービスロボットなど、幅広い分野での実用化が進展しており、AIの次世代応用の本命とも言われる。

*2 デジタル情報を記憶する「半導体メモリ」の一種。PCやスマホなどの内部で、一時的なデータの書き込み・読み出しに用いられる。

*3 半導体メモリの一種で、電源がなくてもデータが維持されることから、USBメモリやSDカードなどの外部メモリに用いられる。

デジタル世界のAI

AIは既に企業のインフラとして必要不可欠な存在に

生成AIやエージェントAIといった、デジタル上で動作するこれまでのAIに関しても、今後の成長余地は大きいと考えられます。

AIは今や、企業の重要なインフラになりつつあります。既にビジネスに組み込まれたAIは生産性や競争力の面で必要不可欠な役割を担って



おり、企業はAIに対して今後も継続的に投資を行なうとみられることから、堅調な市場成長が予想されています。

リアル世界のAI

フィジカルAIの実用化に向けた動きが本格始動

AIはデータ(文章、画像、動画)の作成から、現実世界でモノを動かす(ロボット、自動車など)時代へと、進化しつつあります。

この新たなフェーズでは、膨大な量のデータを、同時かつ継続的に分析する必要があることから、これまで以上にデータセンターの重要性が高まります。

また、フィジカルAIでは、データセンターやAI向けの先端半導体のみならず、ロボットなどに必要なセンサーやアナログ・パワー半導体など、あらゆる半導体の需要が拡大すると見込まれ、市場全体のさらなる拡大を促すと期待されます。

※ 写真はイメージです。

Q. 日本の半導体産業における、現在の注目点について教えてください。

A. 後工程の技術進化である「モア・ザン・ムーア」や、工場建設の増加が周辺産業に及ぼす影響などに注目しています

モア・ザン・ムーア

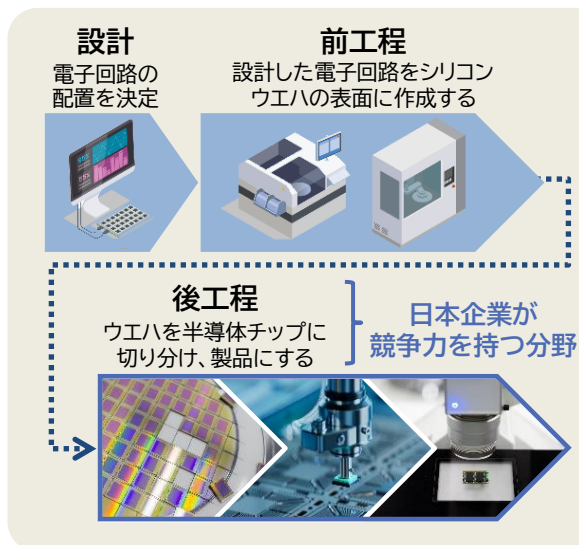
過去、半導体は「ムーアの法則*1」に沿って集積化が進んできました。これまでの技術進化は、回路の線幅を狭めることによって集積度を高める前工程の技術、「微細化」が中心でしたが、近年は線幅が極狭化したことにより、微細化のペースが鈍化傾向にあります。こうした中、半導体の構造を立体化させるなどして3次元集積化を進める「モア・ムーア」のほか、**微細化以外の方法で高性能化をめざす「モア・ザン・ムーア」と呼ばれる、後工程を中心とした取り組みが進んでいます**。最近では、W2W（ウエハ・トゥ・ウエハ）*2と呼ばれる高度な新技術も注目されており、今後の進展が期待されます。

化学反応による加工が中心の前工程に対し、**後工程では精巧なロボティクス技術が要**となります。先進的な後工程技術には、特に精密な制御が必要とされることから、工作機械などに強みを持ち、機械系の技術が蓄積されている**日本企業に高い競争力がある分野**です。今後の半導体の技術進化の中で後工程の重要性が高まるにつれ、**後工程で活躍する日本企業の成長機会は、半導体産業全体と比べても大きく**なると考えられます。

*1 半導体技術の進歩についての経験則で、半導体回路の集積密度は1年半～2年で2倍になるという法則。

*2 複数の半導体を積み重ねる際の新たな配線接合技術で、チップを切り出していない状態のウエハを積層し、接合する方法。

<半導体の製造工程(イメージ)>



工場建設の増加による周辺産業への恩恵

TSMC(台)の日本子会社、JASMの第2工場やルピダスの第2棟をはじめ、日本政府による手厚い支援を背景に、今後も国内で半導体工場の建設が加速する見込みです。そのため、引き続き建設関連の需給は逼迫するとみられ、先端半導体工場の建設に強みを持つ企業や、電気設備、空調管理などのサブコン*3企業などが注目されます。

*3 サブコントラクターの略で、ゼネコンから電気設備や空調設備などの工事を請け負う企業。

<当ファンドの投資対象となる3つのカテゴリー>

カテゴリーⅠ	半導体製造装置や半導体材料の供給を行なう企業
カテゴリーⅡ	半導体の製造にかかわる企業
カテゴリーⅢ	半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺企業

※投資カテゴリーはアモーヴァ・アセットマネジメントが考える分類です。

※当ファンドの投資カテゴリーは上記に限定されるものではなく、将来、変更となる可能性があります。

※ 写真、イラストはイメージです。

※ 記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

Q. 前Qで挙げた注目分野に関連する組入銘柄について教えてください。

イビデ

<投資カテゴリー> 半導体製造装置・半導体材料企業



会社概要

半導体や自動車などの分野で世界有数の企業を支える電子部品メーカー。世界トップレベルの技術力を有し、半導体パッケージ基板の分野で高いシェアを誇る。

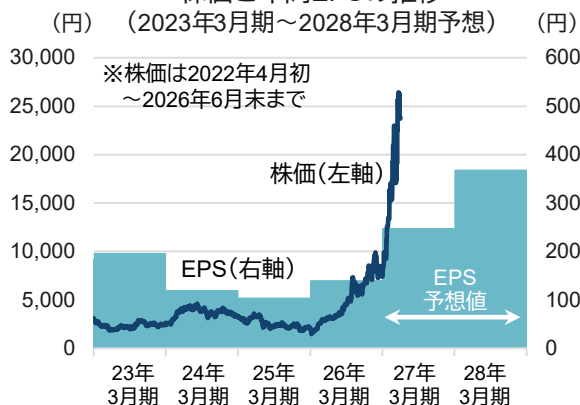
運用者の注目点

データセンターなどへの投資が活発化する中、パッケージ技術を活用した、半導体のさらなる高性能化が求められています。パッケージ基板は現在、**高多層化**や**大型化**などの**技術進化が進んでいる**ことに加え、部品内蔵基板*1やガラスコア基板*2といった**次世代技術への展開も期待**されています。今後**パッケージ技術の付加価値が高まるにつれ、同社の収益拡大**が見込まれます。

*1 電子部品や回路チップなどをプリント基板の表面ではなく、内部に埋め込む技術

*2 半導体チップをプリント基板と接続するためのICパッケージ基板技術の一種

<株価と年間EPSの推移>



東京エレクトロン

<投資カテゴリー> 半導体製造装置・半導体材料企業



会社概要

グローバルトップレベルの半導体製造装置メーカー。前工程技術に関わる幅広い製品で高い市場シェアを有する。

運用者の注目点

半導体の製造において、複数の前工程を担う装置に強みを持つ同社は、**先端半導体の設備投資が拡大する中で、需要拡大の恩恵を受けると**みられます。

加えて、同社はプローバ*3やウエハの貼り合わせ装置といった**後工程の重要な装置も取り扱っている**ことから、後工程技術の進歩に伴う半導体テストの増加や、モア・ザン・ムーアを実現するための技術進化などが、一層の追い風になると期待されます。

*3 ウエハの電気的特性・動作の検査装置

<株価と年間EPSの推移>



次ページに続きます

信頼できると判断したデータなどをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※ EPS(一株当たり利益)予想値は2026年7月時点の市場予想です。 ※ 写真はイメージです。

※ 投資カテゴリーはアモーヴァ・アセットマネジメントが考える分類です。当ファンドの投資カテゴリーは上記に限定されるものではなく、将来、変更となる可能性があります。

上記は、マザーファンドの運用者の見解や公開情報など信用できると判断した情報をもとに、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成しています。記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

前ページより続きます

鹿島建設

<投資カテゴリー> 恩恵を受ける周辺企業



会社概要

国内大手ゼネコン。社会インフラに加え、超高層建築など先駆的なプロジェクトも手掛ける。高度な技術が求められる半導体工場の建設で存在感を示す。

運用者の注目点

同社はJASMやラピダスなどの、数々の大規模先端半導体工場の建設を手掛けたことにより、高い技術やノウハウを獲得しています。

日本国内では、今後数年にわたって継続的に先端半導体の工場建設が行なわれる可能性が高いと見込まれます。先端の半導体ほど、製造工場の建設には高度な技術が必要となることから、こうした状況が同社への強い追い風になるとみられます。

<株価と年間EPSの推移>

(2023年3月期～2028年3月期予想)



扶桑化学工業

<投資カテゴリー> 半導体製造装置・半導体材料企業



会社概要

各種果実酸を製造、販売する果実酸の大手。ウエハの研磨に使用される超高純度コロイダルシリカを中心とした電子材料事業と、リンゴ酸を中心としたライフサイエンス事業を擁する。

運用者の注目点

同社の高純度コロイダルシリカは、ナノレベルでの高い精度が要求されるCMP(化学機械研磨)の分野において、世界的に高いシェアを有しています。

今後、先端半導体の分野では、配線工程におけるCMP工程の増加に加え、後工程においてもCMPの拡大が見込まれることから、同社の収益拡大につながると期待されます。

<株価と年間EPSの推移>

(2023年3月期～2028年3月期予想)



信頼できると判断したデータなどをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

※ EPS(一株当たり利益)予想値は2026年7月時点の市場予想です。 ※ 写真はイメージです。

※ 投資カテゴリーはアモーヴァ・アセットマネジメントが考える分類です。当ファンドの投資カテゴリーは上記に限定されるものではなく、将来、変更となる可能性があります。

上記は、マザーファンドの運用者の見解や公開情報など信用できると判断した情報をもとに、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成しています。記載の銘柄について、売買を推奨するものでも、将来の価格の上昇または下落を示唆するものでもありません。また、当ファンドにおける将来の銘柄の組入れまたは売却を示唆するものでもありません。

※上記は過去のものおよび予想であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

<市場別構成比率>

市場	比率
プライム	95.3%
スタンダード	4.7%
グロース	0.0%
その他	0.0%

<規模別構成比率>

時価総額	比率
1兆円以上	55.6%
5,000億円以上1兆円未満	18.5%
2,000億円以上5,000億円未満	17.1%
2,000億円未満	8.9%

<業種別構成比率上位>

業 種	比率
電気機器	39.9%
機械	20.2%
化学	15.0%
建設業	9.0%
卸売業	4.6%
精密機器	2.7%
繊維製品	2.3%
非鉄金属	1.4%
ガラス・土石製品	1.1%
情報・通信業	0.9%

<投資カテゴリー別構成比率>

投資カテゴリー	比率
半導体製造装置・半導体材料企業	78.3%
半導体の製造にかかわる企業	10.1%
恩恵を受ける周辺企業	11.6%

<組入上位10銘柄>（銘柄数:62銘柄）

	銘柄名	業種	投資カテゴリー	比率
1	アドバンテスト	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	5.98%
2	東京エレクトロン	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	5.97%
3	イビデン	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	4.68%
4	鹿島建設	建設業	恩恵を受ける周辺企業	3.38%
5	SCREENホールディングス	電気機器	半導体製造装置・半導体材料企業	3.19%
6	扶桑化学工業	化学	半導体製造装置・半導体材料企業	2.65%
7	CKD	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	2.63%
8	荏原製作所	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	2.56%
9	四国化成ホールディングス	化学	半導体製造装置・半導体材料企業	2.46%
10	SMC	機械	半導体製造装置・半導体材料企業	2.36%

※ 上記はマザーファンドの状況です。

※ 「市場別構成比率」「規模別構成比率」「投資カテゴリー別構成比率」は、組入銘柄の評価額の合計を100%として計算したものです。

※ 「業種別構成比率上位」「組入上位10銘柄」は、純資産総額比です。

※ 個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また、上記銘柄について、将来の組入れを保証するものではありません。

※ 投資カテゴリーはアモーヴァ・アセットマネジメントが考える分類です。当ファンドの投資カテゴリーは上記に限定されるものではなく、将来、変更となる可能性があります。

※ 上記は過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

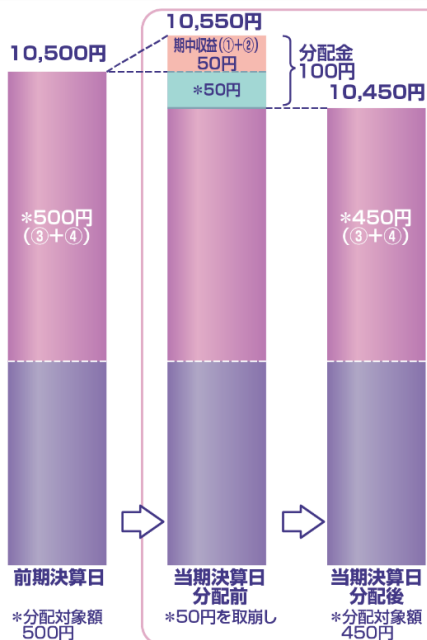
投資信託で分配金が支払われるイメージ



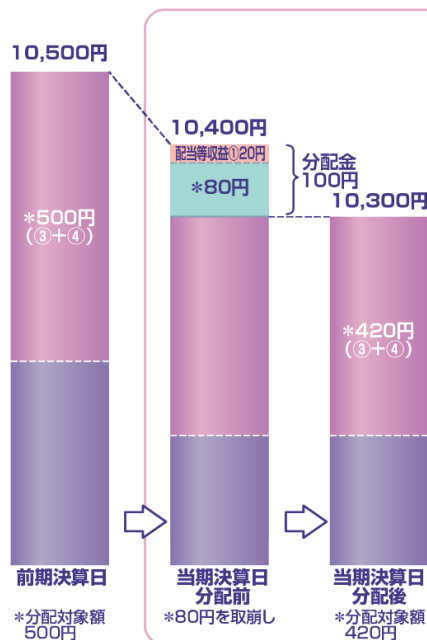
- 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合



前期決算から基準価額が下落した場合



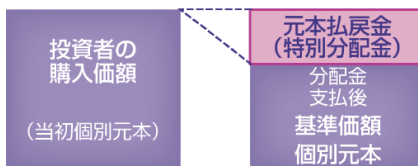
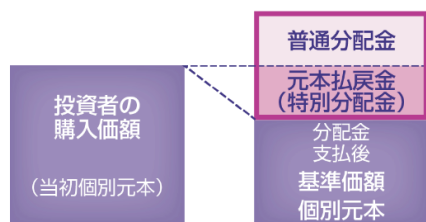
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがいさかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

- ・普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
- ・元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、(特別分配金) 元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

ファンドの特色

1

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている半導体関連企業の株式に投資を行ないます。

2

日本株式の調査・運用に精通したアモーヴァ・アセットマネジメントが運用を行ないます。

3

お客様の運用ニーズに応じて、「1年決算型」と「予想分配金提示型」の2ファンドからお選びいただけます。

※当資料において、「1年決算型」は「ジャパン半導体株式ファンド」を指します。

※ 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行わない場合もあります。

※ 市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【お申込みに際しての留意事項】

リスク情報

投資者の皆様は投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意事項

- 当資料は、投資者の皆様は「ジャパン半導体株式ファンド」および「ジャパン半導体株式ファンド(予想分配金提示型)」へのご理解を高めていただくことを目的として、アモーヴァ・アセットマネジメントが作成した販売用資料です。
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。

※ 当資料に示す各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

【お申込みメモ】

※当資料において、「1年決算型」は「ジャパン半導体株式ファンド」を指します。

商品分類	追加型投信／国内／株式
購入単位	販売会社が定める単位 ※販売会社の照会先にお問い合わせください。
購入価額	購入申込受付日の基準価額
信託期間	【1年決算型】無期限(2023年12月22日設定) 【予想分配金提示型】2036年6月20日まで(2026年6月22日設定)
決算日	【1年決算型】毎年12月20日(休業日の場合は翌営業日) 【予想分配金提示型】毎月20日(休業日の場合は翌営業日)
換金代金	原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

【手数料等の概要】

投資者の皆様には、以下の費用をご負担いただきます。

<申込時、換金時にご負担いただく費用>

購入時手数料	購入時の基準価額に対し3.3%(税抜3%)以内 ※購入時手数料(スイッチングの際の購入時手数料を含みます。)は販売会社が定めます。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※収益分配金の再投資により取得する口数については、購入時手数料はかかりません。 ※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があります。		
換金手数料	ありません。	信託財産留保額	ありません。

<信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用>

運用管理費用 (信託報酬)	ファンドの日々の純資産総額に対し年率1.584%(税抜1.44%)
その他の費用・ 手数料	目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用、運用において利用する指数の標章使用料などについては、 <u>ファンドの</u> <u>日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が</u> 信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、借入金の利息および 立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはでき ません。また、有価証券の貸付は現在行なっておりませんので、それに関連する報酬はかか りません。

※ 投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて
異なりますので、表示することができません。

※ 詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

【委託会社、その他関係法人】

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第368号 加入協会:一般社団法人資産運用業協会
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
販売会社	販売会社については下記にお問い合わせください。 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 [ホームページ]www.amova-am.com [コールセンター]0120-25-1404(午前9時～午後5時。土、日、祝・休日は除く。)

※当資料において、「1年決算型」は「ジャパン半導体株式ファンド」を指します。

【投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは】

1年決算型	予想分配金提示型	金融商品取引業者等の名称		登録番号	加入協会			
					日本証券業協会	資産運用業協会	一般社団法人 金融先物 取引業協会	一般社団法人 第二種金融商品 取引業協会
○		あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第67号	○	○		
○		朝日信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第143号	○			
○		足利小山信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第217号				
○		岩井コスモ証券株式会社	金融商品取引業者	近畿財務局長(金商)第15号	○	○	○	
○		株式会社SBI証券 ※右の他に、以下にも加入 一般社団法人日本STO協会 一般社団法人日本暗号資産等取引業協会 日本商品先物取引協会	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第44号	○	○	○	○
○		株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)	登録金融機関	関東財務局長(登金)第10号	○		○	
○		株式会社愛媛銀行	登録金融機関	四国財務局長(登金)第6号	○			
○		大垣西濃信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第29号				
○		岐阜信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第35号	○			
○		極東証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第65号	○			○
○		呉信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第25号				
○		桑名三重信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第37号				
○		三条信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第244号				
○	○	大熊本証券株式会社	金融商品取引業者	九州財務局長(金商)第1号	○			
○		大山日ノ丸証券株式会社	金融商品取引業者	中国財務局長(金商)第5号	○			
○		高松信用金庫	登録金融機関	四国財務局長(登金)第20号				
○		知多信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第48号				
○		株式会社千葉興業銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第40号	○			
○		東武証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第120号	○			
○		富山信用金庫	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第27号				
○		豊川信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第54号				
○		長野信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第256号	○			
○		奈良信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第71号	○			
○		西尾信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第58号	○			
○		沼津信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第59号				
○		浜松磐田信用金庫	登録金融機関	東海財務局長(登金)第61号				
○		姫路信用金庫	登録金融機関	近畿財務局長(登金)第80号	○			
○		平塚信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第196号				
○		広島信用金庫	登録金融機関	中国財務局長(登金)第44号	○			
○		福井信用金庫	登録金融機関	北陸財務局長(登金)第32号				
○		福岡びびき信用金庫	登録金融機関	福岡財務支局長(登金)第24号	○			
○		松井証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○		○	
○		丸八証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長(金商)第20号	○			
○		株式会社三菱UFJ銀行	登録金融機関	関東財務局長(登金)第5号	○		○	○
○		水戸信用金庫	登録金融機関	関東財務局長(登金)第227号				
○		moomoo証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第3335号	○	○		
○		明和證券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第185号	○			
○		めばき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第1771号	○			
○		楽天証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第195号	○	○	○	○

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

(50音順、2026年6月30日現在)